

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION
中芯國際集成電路製造有限公司*

(于開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 0981)

中芯截至二零零七年十二月三十一日止三個月業績公佈

- 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司（紐約交易所：SMI；香港聯交所：981）（[中芯]或[本公司]）於今日公佈截至二零零七年十二月三十一日止三個月的綜合經營業績。二零零七年第四季的銷售額與二零零六年第四季相比上升 3.0%至 395,300,000 元，與二零零七年第三季度的 391,400,000 元相比上升1.0%。相比較二零零七年第三季的10.8%，二零零七年第四季的毛利率為8.9%是由於 DRAM 市場價格持續下跌所致。二零零七年第四季的淨虧損為21,200,000元，二零零七年第三季為淨虧損25,600,000元。每股美國預托股股份淨虧損（攤薄）為 0.057 元。
- 以下為本公司於二零零八年一月二十九日就截至二零零七年十二月三十一日止三個月的未經審核業績在報章所作的報章公佈全文。
- 本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(1) 條規定的披露責任於二零零八年一月二十九日作出本公佈。

以下為本公司於二零零八年一月二十九日就截至二零零七年十二月三十一日止三個月的未經審核業績在報章所作的報章公佈全文。

所有貨幣數位主要以美元列賬，除非特別指明。

報告內的財務報表數額按美國公認會計原則厘定。

中國上海一二零零八年一月二十九日一國際主要半導體代工製造商中芯國際積體電路製造有限公司（紐約交易所：SMI；香港聯交所：981）（「中芯」或「本公司」）於今日公佈截至二零零七年十二月三十一日止三個月的綜合經營業績。

二零零七年概要

- 二零零七年的銷售額與二零零六年相比上升5.8%至1,549,800,000元，儘管DRAM市場遭遇前所未有的寒冬。
- 毛利由二零零六年上升20%至二零零七年的152,700,000元是由於非DRAM業務的穩固成長。
- 二零零七年的毛利率為9.9%，相較於二零零六年的8.7%。
- 二零零七年的淨虧損為40,000,000元，二零零六年的淨虧損44,100,000元。

二零零七年第四季的概要

- 二零零七年第四季的銷售額與二零零六年第四季相比上升3.0%至395,300,000元，與二零零七年第三季度的391,400,000元相比上升1.0%。
- 相比較二零零七年第三季毛利率10.8%，二零零七年第四季的毛利率為8.9%是由於DRAM市場價格持續下跌所致。
- 二零零七年第四季的淨虧損為21,200,000元，二零零七年第三季為淨虧損25,600,000元主要受DRAM業務的影響。
- 每股美國預托股份淨虧損（攤薄）為0.057元。

關於本季營運成果，中芯國際總執行長張汝京博士透過電話會議向分析員們表示：“中芯國際在2007年第四季的營收較去年同期及上一季均呈現成長。營運方面，2007年第四季度末月產能增至185,250片8寸等值晶圓，同時維持94%高產能利用率。相較2006年，2007年全年的晶片出貨與銷售分別成長14.6%與5.8%。

誠如我們的計劃，為減緩DRAM持續價格下滑的傷害，我們在第四季減少DRAM晶圓代工服務，在不計2007年第四季度為出清停產DRAM庫存之單一大量出貨情況下，我們本季DRAM出貨已較2007年第一季減少22%。相較前一季，即使在更艱困的DRAM環境下，我們仍能成功地減少第四季度虧損。我們預期在2008年的第一季DRAM的營收比重將縮減至20%以下，並在往後一年內持續減少DRAM比重。

中芯國際在非DRAM業務呈現穩固的成長。2007年非DRAM業務的營收由2006年的9.88億美元成長13.5%至11.21億美元，且全年非DRAM業務之毛利率成長達104%。隨著更多的邏輯客戶採用更先進的制程，我們0.13微米與90納米的邏輯銷售亦較2006年大幅成長42%。

伴隨著整個半導體市場在中國持續快速的發展，中芯國際2007年在中國地區銷售額呈現56%之成長，充分顯示其掌握此一成長趨勢之能力。我們很高興看到中國客戶方面不斷的進步，同時亦將持續致力於中國市場的開發與拓展。

我們在2007年觀察到晶圓代工業務來自於手機晶片，電源管理晶片，無線區域網路及一些消費性產品如機上盒，數位電視及MP3/MPEG4的強勁需求，反映了整個產業需求概況，同時在2007年，我們新增了77個全球客戶，年增長23.3%，其中中國客戶占了一大部分。

為了配合我們自有研發，以及強化對客戶的服務，我們宣佈與IBM簽定45納米Bulk COMS技術許可協定。此一協定有助於加速我們邏輯工藝技術的發展以及用我們的12英寸廠為客戶

提供最佳解決方案。隨著技術發展藍圖延伸至 45 納米，我們亦觀察到越來越多的客戶向我們尋求 90 納米、65 納米晶圓代工的服務。

部分因 45 納米工藝計劃的投資，使得我們在第四季的資本支出增加至 2.6 億美元。2008 年在先進制程的持續開發下及北京廠 DRAM 產能轉換邏輯的計劃下，預期全年資本支出約 7 億美元。

在營運方面，我們計劃在深圳建設集成電路晶片生產線專案。中芯國際將在深圳註冊成立獨立法人資格的中芯國際集成電路製造（深圳）有限公司，分步建設包括集成電路技術研究發展中心，一條 8 英寸與一條 12 英寸晶圓生產線。在 12 英寸工廠中將導入 IBM 公司授權其使用的先進制程工藝技術。深圳市政府將在資金、優惠政策及運作方式等方面全力支援該專案。專案預計在今年上半年開始動工。

我們相信隨著我們的營業計劃不斷的進展，不斷達到新技術里程碑，我們將為股東的利益奠定未來成長和發展的堅實基礎。”

電話會議 / 網上業績公佈詳情

日期：二零零八年一月三十日

時間：上海時間上午八時三十分

撥號及登入密碼：美國 1-617-597-5342（密碼：SMIC）或香港 852-3002-1672（密碼：SMIC）。

二零零七年第四季業績公佈網上直播可於 www.smics.com 網站「投資者關係」一欄收聽。中芯網站在網上廣播後為期十二個月提供網上廣播錄音版本連同本新聞發佈的軟拷貝。

關於中芯

中芯國際集成電路製造有限公司（“中芯國際”，紐約證交所股票代碼：SMI，香港聯合交易所股票代碼：981）總部位於中國上海，是世界領先的集成電路晶片代工企業之一，也是中國內地規模最大、技術最先進的積體電路晶片製造企業。中芯國際向全球客戶提供 0.35 微米到 65 納米及更先進的晶片代工服務。中芯國際在上海建有三座 8 吋晶片廠和一座 12 吋晶片廠。北京建有兩座 12 吋晶片廠，在天津建有一座 8 吋晶片廠。中芯國際還在美國、義大利、日本提供客戶服務和設立營銷辦事處，同時在香港設立了代表處。此外，中芯在成都建有封裝測試廠以及有一座代為經營管理的 8 吋晶片廠，在武漢有一座代為經營管理的先進的 12 吋晶片廠。詳細資訊請參考中芯國際網站 <http://www.smics.com>

安全港聲明

(根據 1995 私人有價證券訴訟改革法案)

本次新聞發佈可能載有(除歷史資料外)依據1995美國私人有價證券訴訟改革法案的“安全港”條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述,包括關於二零零八年第一季銷售額的預期, DRAM的銷售額占總銷售額的比例將於二零零八年下降的預期, 65納米技術的產品開始商業生產時間的預期, 中芯於二零零八年盈利能力增長和改善的預期, 以及在隨後“資本開支概要”和“二零零八年第一季度指引”中的聲明乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「計劃」、「估計」、「預計」、「預測」及類似表述為該等前瞻性陳述之標識, 儘管並非所有前瞻性陳述均包含上述字眼。該等前瞻性陳述乃反映中芯高級管理層根據最佳判斷作出的估計, 存在重大已知及未知風險、不確定性, 以及其他可能導致中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素, 包括(但不限於)與半導體行業周期及市場狀況有關的風險、激烈競爭、中芯客戶能否及時接收晶圓產品、能否及時引進新技術、中芯量產新產品的能力、半導體代工服務供求情況、行業產能過剩、設備、零件及原材料短缺、繼續中訴訟的裁定/判決、製造生產量供給及最終市場的金融局勢是否穩定。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會(「證交會」)的文件資料, 包括其於二零零七年六月二十九日以 20-F 表格形式呈交予證交會的經修訂的年度報告, 特別是「風險因素」及「有關財政狀況及經營業績的管理層討論及分析」兩個部份, 以及中芯可能不時向證交會及香港聯交所呈交的該等其他文件, 包括 6-K 表格。其他未知或不可預知的因素亦可能會對中芯日後的業績、表現或成就造成重大不利影響。鑒於上述風險、不確定性、假設及因素, 本新聞發佈中提及的前瞻性事件可能不會發生。務請閣下注意, 切勿過份依賴此等前瞻性陳述, 此等陳述僅就本新聞發佈中所載述日期(或如無有關日期, 則為本新聞發佈日期)的情況而表述。除法律有所規定以外, 中芯概不就因新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況承擔任何責任, 亦不擬更新任何前瞻性陳述。

台積電法律訴訟之近期發展

二零零六年八月二十五日, 台積電於美國加州阿拉米達郡高級法院, 指稱本公司違反和解協定、違反本票約定及不當使用商業機密而對本公司及若干子公司(中芯上海、中芯北京及中芯美國)提出訴訟。台積電訴求(其中包括)損害賠償、禁制令、律師費及提前支付和解協定項下尚未支付之金額。

在目前的訴訟中, 台積電指稱本公司將台積電之商業機密運用於製造本公司 0.13 微米或更小制程之產品。台積電進一步稱, 由於本公司違約, 台積電對本公司的專利授權隨之終止, 而有關對於本公司較大工藝產品之不起訴承諾亦已失效。

本公司強烈否認所有不當使用之指控。此外, 台積電尚未證明、亦未拿出任何證據證明本公司之任何不當使用行為。目前, 該訴求仍為未經證明的指控, 而為本公司所否認。

本公司於二零零六年九月十三日公佈，除提出強烈否認台積電在美國訴訟中提出的指控外，本公司已於二零零六年九月十二日在美國反訴台積電，就（其中包括）台積電違反合約及違反默示的誠信及公平交易的承諾，要求台積電作出損害賠償。

中華人民共和國北京市高級人民法院於二零零六年十一月十六日受理本公司及本公司的全資子公司中芯上海及中芯北京共同提起的針對台積電違反誠實信用原則、商業詆毀的不公平競爭行為的指控（「中國訴訟」）。在中國訴訟中，本公司尋求（其中包括）判令台積電停止侵權行為、公開向本公司道歉和賠償（包括台積電因其侵權行為所獲得的利潤）。

台積電於二零零七年一月向美國加州法院聲請禁止中國訴訟。於二零零七年二月，台積電向北京市高級人民法院提出司法管轄權的異議，質疑北京市高級人民法院對中國訴訟的司法管轄許可權。

於二零零七年三月，加州法院駁回台積電有關禁制中國訴訟的聲請。台積電就加州法院的裁定提出上訴。

於二零零七年七月，北京市高級人民法院駁回台積電對中國訴訟的司法管轄權異議，並認為北京市高級人民法院對審理該訴訟擁有適當的司法管轄權。台積電就北京市高級人民法院的裁定，向中華人民共和國最高人民法院提出上訴。最高人民法院已於二零零八年一月七日開庭審理此上訴案，目前尚未對此作出判決。

二零零七年八月十四日，本公司對台積電提出修正的反訴，尋求（其中包括）台積電違反和解協定及專利許可合同的賠償。台積電隨後否認本公司關於修正反訴的指摘，並追加指稱本公司於北京市高級人民法院起訴台積電乃違反和解協定；經本公司之聲請，加州法院依程式上不適當排除此新的指稱，但同意台積電依適當程式重新主張。

二零零七年八月十五日至十七日，美國加州法院就台積電申請臨時禁制令欲禁止中芯國際製造或分銷特定的 0.13um 或以下的邏輯技術產品作出聆訊。法院在二零零七年九月七日作出裁定，該裁定駁回台積電提出的臨時禁制令申請，因而本公司的業務發展及銷售得以不受影響。然而，該裁定要求本公司若在某些情況下披露其邏輯技術予非中芯的機構時，必須於 10 天前通知台積電，以讓台積電可就該披露提出反對。

根據美國財務會計準則第 144 號，本公司須決定該未決訴訟是否構成需要進一步分析專利許可組合是否已受損害之事件。我們相信，該法律訴訟現處於十分早期階段，我們仍在評估訴訟是否屬於該類事件。本公司預期將會獲得進一步資料以協助我們做出決定。根據美國財務會計準則第 144 號進行之任何損害分析結果可能對本公司財務狀況及經營業績產生重大影響。由於訴訟仍處於早期階段，本公司未能評估頒佈不利判決的可能性或估計潛在虧損的金額或範圍。

投資者聯絡資料:

Theresa Teng

電話: +86-21-5080-2000 內線 16278

theresa_teng@smics.com

Phyllis Liu

電話: +86-21-5080-2000 內線 12315

phyllis_liu@smics.com

Anne Wong Chen

電話: +86-21-5080-2000, 內線: 12804

Anne_CAYW@smics.com

二零零七年第四季經營業績概要:

以千美元為單位 (每股盈利和百分比除外)

	二零零七年第 四季度	二零零七年第 三季度	季度比較	二零零六年 第四季度 ⁽³⁾	年度比較
銷售收入	395,254	391,398	1.0%	383,813	3.0%
銷售成本	360,207	349,148	3.2%	364,339	-1.1%
毛利	35,047	42,250	-17.0%	19,474	80.0%
經營開支	57,389	62,435	-8.1%	5,762	896.0%
經營收益 (虧損)	(22,342)	(20,185)	10.7%	13,712	-
其他收入 (支出), 淨額	(1,655)	(4,342)	-61.9%	(16,468)	-90.0%
所得稅利益 (支出)	2,557	(966)	-	3,002	-
稅後淨收入 (虧損)	(21,440)	(25,493)	-15.9%	246	-
少數股權	1,157	859	34.7%	941	23.0%
應占聯營公司虧損	(881)	(919)	-4.1%	(1,044)	-15.6%
普通股持有人應占收入 (虧損)	(21,164)	(25,553)	-17.2%	143	-
毛利率	8.9%	10.8%		5.1%	
經營利潤率	-5.7%	-5.2%		3.6%	
每股普通股股份淨收入 (虧損) - 基本 ⁽¹⁾	(0.0011)	(0.0014)		0.0000	
每股美國預托股份淨收入 (虧損) - 基本	(0.0570)	(0.0690)		0.0000	
每股普通股股份淨收入 (虧損) - 攤薄 ⁽¹⁾	(0.0011)	(0.0014)		0.0000	
每股美國預托股份淨收入 (虧損) - 攤薄	(0.0570)	(0.0690)		0.0000	
付運晶圓 (8吋等值) ⁽²⁾	497,454	458,466	8.5%	424,395	17.2%
產能使用率	94.4%	94.1%	-	86.6%	-

附注:

(1) 基於二零零七年第四季加權平均普通股 18,550,000,000 股 (基本) 及 18,550,000,000 股 (攤薄), 二零零七年第三季度 18,523,000,000 股 (基本) 及 18,523,000,000 股 (攤薄), 二零零六年第四季度 18,398,000,000 股 (基本) 及 18,609,000,000 股 (攤薄)。

(2) 包括銅接連件

(3) 重列

- 二零零七第四季銷售額升至 395,300,000 元，較二零零七年第三季的 391,400,000 元錄得季度升幅 1.0%，並較二零零六年第四季度的 383,800,000 元錄得年度升幅 3.0%。
- 銷售成本從二零零七年第三季的 349,100,000 元上升 3.2% 至二零零七年第四季的 360,200,000 元，主要由於晶圓付運數量增加所致。
- 二零零七年第四季毛利下降至 35,000,000 元，較二零零七年第三季的 42,300,000 元錄得季度降幅 17.0%；較二零零六年第四季度的 19,500,000 元錄得年度升幅 80.0%。
- 毛利率從二零零七年第三季的 10.8% 下降至二零零七年第四季 8.9%，主要是由於 DRAM 價格下滑造成平均銷售價格較低所致。
- 二零零七年第四季的總經營開支由二零零七年第三季的 62,400,000 元下降至 57,400,000 元，錄得季度降幅 8.1%，主要由於一般行政費用下降所致。
- 二零零七年第四季的研發費用增加至 26,200,000 元，較二零零七年第三季的 25,900,000 元錄得季度升幅 1.1%。
- 一般行政費用由二零零七年第三季的 23,800,000 元下降至二零零七年第四季的 18,800,000 元，主要是匯兌虧損及律師費用減少所致。二零零七年第四季來自於經營活動的匯兌虧損是 900,000 元，而二零零七年第三季的匯兌虧損為 5,700,000 元。合併來自於非經營性活動的匯兌收益（記入其他收入），二零零七年第四季的總匯兌收益為 3,600,000 元，而二零零七年第三季的總匯兌收益為 2,000,000 元。
- 二零零七年第四季的銷售及市場推廣相關費用上升至 5,700,000 元，較二零零七年第三季 4,900,000 元錄得季度升幅 16.1%，主要是由於與銷售行為相關的工程材料耗用增加所致。

1. 收入分析

銷售分析			
以應用分類	二零零七年第 四季度	二零零七年第 三季度	二零零六年第 四季度
電腦	22.9%	22.7%	36.3%
通訊	47.4%	50.0%	40.1%
消費	22.7%	18.3%	19.3%
其他	7.0%	9.0%	4.3%
以服務類別分類	二零零七年第 四季度	二零零七年第 三季度	二零零六年第 四季度
邏輯 ⁽³⁾	67.4%	66.8%	57.4%
記憶	23.6%	23.6%	38.6%
管理服務	1.5%	3.1%	0.5%
光罩製造，探測及其它	7.5%	6.5%	3.5%
以客戶類別分類	二零零七年第 四季度	二零零七年第 三季度	二零零六年第 四季度
非廠房半導體公司	49.3%	45.5%	36.1%
集成裝置製造商	38.5%	40.0%	55.8%
系統公司及其它	12.2%	14.5%	8.1%
以地區分類	二零零七年第 四季度	二零零七年第 三季度	二零零六年第 四季度
北美洲	44.6%	44.7%	36.3%
亞太區（不包括日本）	26.4%	26.4%	20.0%
日本	10.4%	10.1%	11.3%
歐洲	18.6%	18.8%	32.4%
晶圓收入分析			
各技術占晶圓銷售額的百分比（僅包括邏輯、記憶及銅接連件）	二零零七年第 四季度	二零零七年第 三季度	二零零六年第 四季度
0.09 微米	25.3%	26.7%	14.4%
0.13 微米	24.4%	28.6%	43.0%
0.15 微米	5.5%	2.0%	2.4%
0.18 微米	28.3%	28.8%	33.3%
0.25 微米	0.5%	1.0%	1.6%
0.35 微米	16.0%	12.9%	5.3%
各邏輯技術占邏輯晶圓銷售額百分比 ⁽¹⁾	二零零七年第 四季度	二零零七年第 三季度	二零零六年第 四季度
0.09 微米	7.7%	13.7%	14.7%
0.13 微米 ⁽²⁾	21.0%	22.7%	14.0%
0.15 微米	7.7%	2.7%	4.2%
0.18 微米	40.3%	41.0%	54.8%
0.25 微米	0.6%	1.4%	2.8%
0.35 微米	22.7%	18.5%	9.5%

附注：

- (1) 不包括 0.13 微米銅接連件
- (2) 代表來自于全流程製造晶圓的銷售收入
- (3) 包括 0.13 微米銅接連件

• 產能：

廠 / (晶圓尺寸)	二零零七年第四 季度*	二零零七年第三 季度*
上海廠 (8 吋) ⁽¹⁾	98,000	98,000
北京廠 (12 吋) ⁽²⁾	65,250	61,200
天津廠 (8 吋)	22,000	21,000
每月晶圓裝配總產能	185,250	180,200

附注：

* 期終每月晶圓計 8 吋等值

- (1) 上海廠目前包括晶圓一廠，晶圓二廠和晶圓三廠
- (2) 北京廠目前包括晶圓四廠，晶圓五廠和晶圓六廠

- 截至二零零七年第四季度末，每月產能增加至 185,250 片 8 吋等值晶圓。

付運及使用率：

8 吋等值晶圓	二零零七年第四 季度	二零零七年第三 季度	二零零六年第四 季度
付運晶圓 (包括銅接連件)	497,454	458,466	424,395
使用率 ⁽¹⁾	94.4%	94.1%	86.6%

附注：

(1) 產能使用率按輸出晶圓總額除以估計產能計算

- 二零零七年第四季晶圓付運增加至 497,454 片 8 吋等值晶圓，較二零零七年第三季的 458,466 片 8 吋等值晶圓及二零零六年第四季度的 424,395 片 8 吋等值晶圓分別錄得季度升幅 8.5% 及年度升幅 17.2%。

2. 詳細財務分析

毛利分析

以千美元計	二零零七年第四 季度	二零零七年第 三季度	季度比較	二零零六年第 四季度	年度比較
銷售成本	360,207	349,148	3.2%	364,339	-1.1%
折舊	161,232	151,720	6.3%	210,045	-23.2%
其他製造成本	190,671	189,069	0.8%	145,673	30.9%
遞延成本攤銷	5,886	5,886	-	5,886	-
股權報酬	2,418	2,473	-2.2%	2,735	-11.6%
毛利	35,047	42,250	-17.0%	19,474	80.0%
毛利率	8.9%	10.8%	-	5.1%	-

- 銷售成本從二零零七年第三季的349,100,000元上升3.2%至二零零七年第四季的360,200,000元, 主要由於晶圓付運數量增加所致。
- 二零零七年第四季毛利下降至35,000,000元, 較二零零七年第三季的42,300,000元錄得季度降幅17.0%; 較二零零六年第四季度的19,500,000元錄得年度升幅80.0%。
- 毛利率從二零零七年第三季的10.8%下降至二零零七年第四季8.9%, 主要是由於DRAM價格下滑造成平均銷售價格較低所致。

經營開支分析

以千美元計	二零零七年第四 季度	二零零七年第 三季度	季度比較	二零零六年第 四季度	年度比較
總經營開支	57,389	62,435	-8.1%	5,762	896.0%
研究及開發	26,201	25,906	1.1%	21,913	19.6%
一般及行政	18,820	23,836	-21.0%	14,563	29.2%
銷售及市場推廣	5,688	4,901	16.1%	4,729	20.3%
無形資產攤銷	6,878	7,751	-11.3%	6,291	9.3%
資產處置虧損(收入)	-198	41	-	-41,734	-99.5%

- 二零零七年第四季的總經營開支由二零零七年第三季的62,400,000元下降至57,400,000元, 錄得季度降幅8.1%, 主要由於一般行政費用下降所致。
- 二零零七年第四季的研發費用增加至26,200,000元, 較二零零七年第三季的25,900,000元錄得季度升幅1.1%。
- 一般行政費用由二零零七年第三季的23,800,000元下降至二零零七年第四季的18,800,000元, 主要是匯兌虧損及律師費用減少所致。二零零七年第四季來自於經營活動的匯兌虧損是900,000元, 相較於二零零七年第三季5,700,000元。合併來自於非經營性活動的匯兌收益(記入其他收入), 二零零七年第四季的總匯兌收益為3,600,000元, 而二零零七年第三季為2,000,000元。
- 二零零七年第四季的銷售及市場推廣相關費用上升至5,700,000元, 較二零零七年第三季4,900,000元錄得季度升幅16.1% 主要是由於與銷售行為相關的工程材料耗用增加所致。

其他收入（支出）

以千美元計	二零零七年第四 季度	二零零七年第三 季度	季度比較	二零零六年第四 季度	年度比較
其他收入(支出)	-1,655	-4,343	-61.9%	-16,468	-90.0%
利息收入	3,971	2,819	40.9%	3,311	19.9%
利息支出	-11,485	-14,791	-22.4%	-14,263	-19.5%
其他，淨額	5,859	7,629	-23.2%	-5,516	-

- 二零零七年第四季其他非經營性虧損為 1,700,000 元，二零零七年第三季度的虧損為 4,300,000 元，主要是由於收到來自於政府的關於 12 英寸晶圓廠運營的利息補貼。
- 其他，淨額減少是由於二零零七年第四季來自於非經營活動的匯兌收益為 4,600,000 元，而二零零七年第三季度為 7,700,000 元。合併來自於經營活動的匯兌虧損，二零零七年第四季的總匯兌收益為 3,600,000 元，二零零七年第三季度的總匯兌收益為 2,000,000 元。

流動資金

以千美元計	二零零七年第四 季度	二零零七年第三 季度
現金及現金等價物	469,284	438,262
短期投資	7,638	14,672
應收賬款	298,388	308,020
存貨	248,310	254,875
其他	51,682	80,614
流動資產總計	1,075,302	1,096,443
應付賬款	301,993	387,356
短期借款	107,000	70,000
長期借款的即期部份	340,693	290,744
其他	179,355	144,326
流動負債總計	929,040	892,426
現金比率	0.5x	0.5x
速動比率	0.8x	0.9x
流動比率	1.2x	1.2x

資本結構

以千美元計	二零零七年第四 季度	二零零七年第三 季度
現金及現金等價物	469,284	438,262
短期投資	7,638	14,672
長期票據的即期部分	29,242	29,493
長期票據	51,057	64,996
短期借款	107,000	70,000
長期借款的即期部份	340,693	290,744
長期借款	616,295	587,091
總借款	1,063,988	947,835
股東權益	2,991,976	3,007,379
總借款對權益比率	35.6%	31.5%

現金流量概要

以千美元計	二零零七年第四 季度	二零零七年第三 季度
來自于經營活動的淨現金	195,872	142,910
來自于投資活動的淨現金	-266,780	-109,353
來自於融資活動的淨現金	101,946	-24,571
現金變動淨額	31,022	8,936

資本開支概要

- 二零零七年第四季資本開支為 260,000,000 元。
- 計劃下的二零零八年資本開支總額將約為 700,000,000 元，並將基於市場狀況作調整。

二零零八年第一季指引

以下聲明為前瞻性陳述，此陳述基於目前的期望並涵蓋風險和不確定性，部分已于之前的安全港聲明中闡明。

- 銷售額預期與二零零七年第四季度持平或微降。
- 經營開支相對銷售的百分比預期介於 16%-19%。
- 資本開支預期約介於 200,000,000 元至 230,000,000 元之間。

- 折舊及攤銷預期約介於 190,000,000 元至 210,000,000 元之間。

近期公佈

- 中芯國際與 IBM 簽訂技術許可協定（二零零七年十二月二十六日）
- 中芯國際上海 12 英寸晶片生產線成功投產（二零零七年十二月十日）
- 中芯國際二零零七年第三季業績報告（二零零七年十月三十日）
- Spansion 與中芯國際簽署晶圓代工協定，生產 300mm、65nm MirrorBit 產品（二零零七年十月二十四日）
- SMIC 推出基於 CPF 的 CADENCE 低功耗數位參考流程（二零零七年十月二十四日）
- SMIC 和 Magma 宣佈提供基於 SMIC 90 納米低功耗制程的增強版參考流程（二零零七年十月十八日）
- 中芯國際二零零七年技術研討會在北京召開（二零零七年十月十七日）
- 截止二零零七年六月三十日止六個月未經審核中期業績公佈（二零零七年九月二十日）
- 美國法院駁回台積電針對與中芯國際訴訟中提出的臨時禁制令申請（二零零七年九月九日）

上述公佈詳情請參閱中芯網站。

http://www.smics.com/website/enVersion/Press_Center/pressRelease.jsp

合并資產負債表
(美元)

截至以下日期止

二零零七年十二月三十一日
(未經審核)

二零零七年九月三十日
(未經審核)

資產

流動資產:

現金及現金等價物	469,284,013	438,262,051
短期投資	7,637,870	14,672,297
應收賬款, 已扣除撥備(二零零七年十二月三十一日為4,492,090元, 二零零七年九月三十日為4,496,016元)	298,387,652	308,020,158
存貨	248,309,765	254,874,702
預付款項及其它流動資產	31,237,755	27,310,047
廠房、機台及其它固定資產銷售應收款	17,321,000	50,180,365
待售資產	3,123,567	3,123,567

流動資產合計 **1,075,301,622** **1,096,443,187**

土地使用權, 淨額	57,551,991	47,133,249
廠房及設備, 淨額	3,202,957,665	3,275,509,427
購入無形資產, 淨額	232,195,132	72,925,914
遞延成本	70,637,275	76,523,714
股權投資	9,896,398	10,782,486
其他長期預付款	2,988,404	3,179,173
遞延稅資產	36,179,563	34,582,059

資產合計 **4,687,708,050** **4,617,079,209**

負債及股東權益

流動負債:

應付帳款	301,992,739	387,356,058
預提費用及其它流動負債	150,109,963	114,781,960
短期借款	107,000,000	70,000,000
長期票據的即期部份	29,242,000	29,492,873
長期借款的即期部份	340,692,788	290,744,282
應付所得稅	2,647	51,233

流動負債合計 **929,040,137** **892,426,406**

長期負債:

長期票據	51,057,163	64,995,655
長期借款	616,294,743	587,090,705
與特許權協定相關的長期應付款	62,833,433	26,453,014
遞延稅負債	1,561,860	2,633,174

長期負債合計 **731,747,199** **681,172,548**

負債合計 **1,660,787,336** **1,573,598,954**

少數股權	34,944,408	36,101,510
股東權益：		
普通股，面值 0.0004 元，法定股份為 50,000,000,000 股，截止二零零七年十二月三十一日已發行股份為 18,558,919,712 股，截止二零零七年九月三十日已發行的股份為 18,536,981,058 股。	7,423,568	7,414,793
認股權證	32,387	32,387
額外繳入股本	3,313,343,585	3,307,574,393
累計其他綜合盈餘(虧損)	(1,881)	14,195
累計虧絀	(328,821,353)	(307,657,023)
所有股東權益合計	2,991,976,306	3,007,378,745
總負債及股東權益合計	4,687,708,050	4,617,079,209

合并營運報表
(美元)

	截至以下日期止三個月	
	二零零七年十二月 三十一日 (未經審核)	二零零七年九月 三十日 (未經審核)
銷售額	395,253,703	391,397,891
銷售成本	360,206,661	349,147,976
毛利	35,047,042	42,249,915
經營費用:		
研究和開發	26,201,351	25,906,095
一般及行政	18,820,136	23,835,922
銷售和市場推廣	5,687,731	4,900,813
購入無形資產攤銷	6,877,899	7,750,931
來自廠房設備和其他固定資產的銷售損失 (所得)	(198,339)	41,576
經營費用總額	57,388,778	62,435,337
經營虧損	(22,341,736)	(20,185,422)
其他收入(支出):		
利息收入	3,970,875	2,819,431
利息支出	(11,485,321)	(14,790,753)
匯兌收益(虧損)	4,613,449	7,722,330
其他,淨額	1,245,530	(93,208)
其他收入(支出),淨額	(1,655,467)	(4,342,200)
所得稅、少數股權及股權投資虧損前淨虧損	(23,997,203)	(24,527,622)
所得稅利益(費用)	2,557,289	(965,676)
少數股權	1,157,102	859,147
股權投資虧損	(881,518)	(918,560)
淨虧損	(21,164,330)	(25,552,711)
每股股份淨虧損,基本	(0.0011)	(0.0014)
每股美國預托股份淨虧損,基本	(0.0570)	(0.0690)
每股股份淨虧損,攤薄	(0.0011)	(0.0014)
每股美國預托股份淨虧損,攤薄	(0.0570)	(0.0690)
用作計算基本每股普通股	18,550,143,535	18,523,392,676

虧損額的股份

用作計算攤薄每股普通股
虧損額的股份

18,550,143,535

18,523,392,676

* 遞延股票報酬攤銷乃關於：

銷售成本

2,417,679

2,472,711

研究和開發

975,621

875,343

一般管理

1,158,530

880,402

銷售和市場推廣

432,672

427,639

合并现金流量表
(美元)

	截至以下日期止三个月	
	二零零七年十二月 三十一日 (未經審核)	二零零七年九月 三十日 (未經審核)
經營活動:		
淨虧損	(21,164,330)	(25,552,711)
淨虧損至經營活動所得(所耗)現金淨額對賬的調整:		
少數股權	(1,157,102)	(859,147)
處置廠房及設備損失(收益)	(198,339)	41,576
折舊及攤銷	180,926,964	176,792,146
購入無形資產攤銷	6,877,899	7,750,931
股權報酬	4,984,502	4,656,095
長期票據非現金利息費用	1,308,496	1,051,275
股權投資虧損	881,518	918,560
營運資產及負債的變動:		
應收賬款, 淨額	9,632,506	(7,640,924)
存貨	6,564,937	(16,908,684)
預付款及其它流動資產	(9,940,469)	(7,675,557)
應付賬款	37,912,146	(7,269,481)
預提費用及其它流動負債	(18,039,712)	16,811,333
應付所得稅	(48,587)	(108,188)
遞延稅資產	(1,597,504)	(1,545,585)
遞延稅負債	(1,071,315)	2,448,807
經營活動所得現金淨額	195,871,610	142,910,446
投資活動:		
購入廠房及設備	(238,379,890)	(161,067,992)
處置廠房及設備所得款項	35,195,311	53,182,673
出售待售資產所得款項	9,075,076	935,393
購買所獲無形資產	(79,704,504)	(3,933,399)
購買短期投資	(42,590,425)	(28,807,101)
出售短期投資	49,624,851	30,337,271
投資活動所耗現金淨額	(266,779,581)	(109,353,155)
融資活動:		
短期借款所得款項	77,658,000	17,000,000
長期借款所得款項	249,509,832	12,737,840
償還長期票據支付的款項	(15,000,000)	-
償還長期借款支付的款項	(170,357,288)	-
償還短期借款支付的款項	(40,658,000)	(55,000,000)
行使僱員購股權所得款項	814,965	691,393
回購限制普通股	(21,500)	-

融資活動所得（所耗）現金淨額	101,946,009	(24,570,767)
匯率變動的影響	(16,076)	(50,679)
現金及現金等價物增加淨額	31,021,962	8,935,845
現金及現金等價物一期間開始	438,262,051	429,326,206
現金及現金等價物一期間結束	469,284,013	438,262,051

於本公佈刊發日期，本公司董事分別有董事會主席兼獨立非執行董事王陽元先生、本公司總裁、首席執行官兼執行董事張汝京先生、本公司非執行董事汪正綱先生、以及本公司獨立非執行董事徐大麟先生、川西剛先生、蕭崇河先生、陳立武先生、虞有澄先生及江上舟先生。

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
首席執行官
張汝京

中國上海，二零零八年一月二十九日
* 僅供識別